

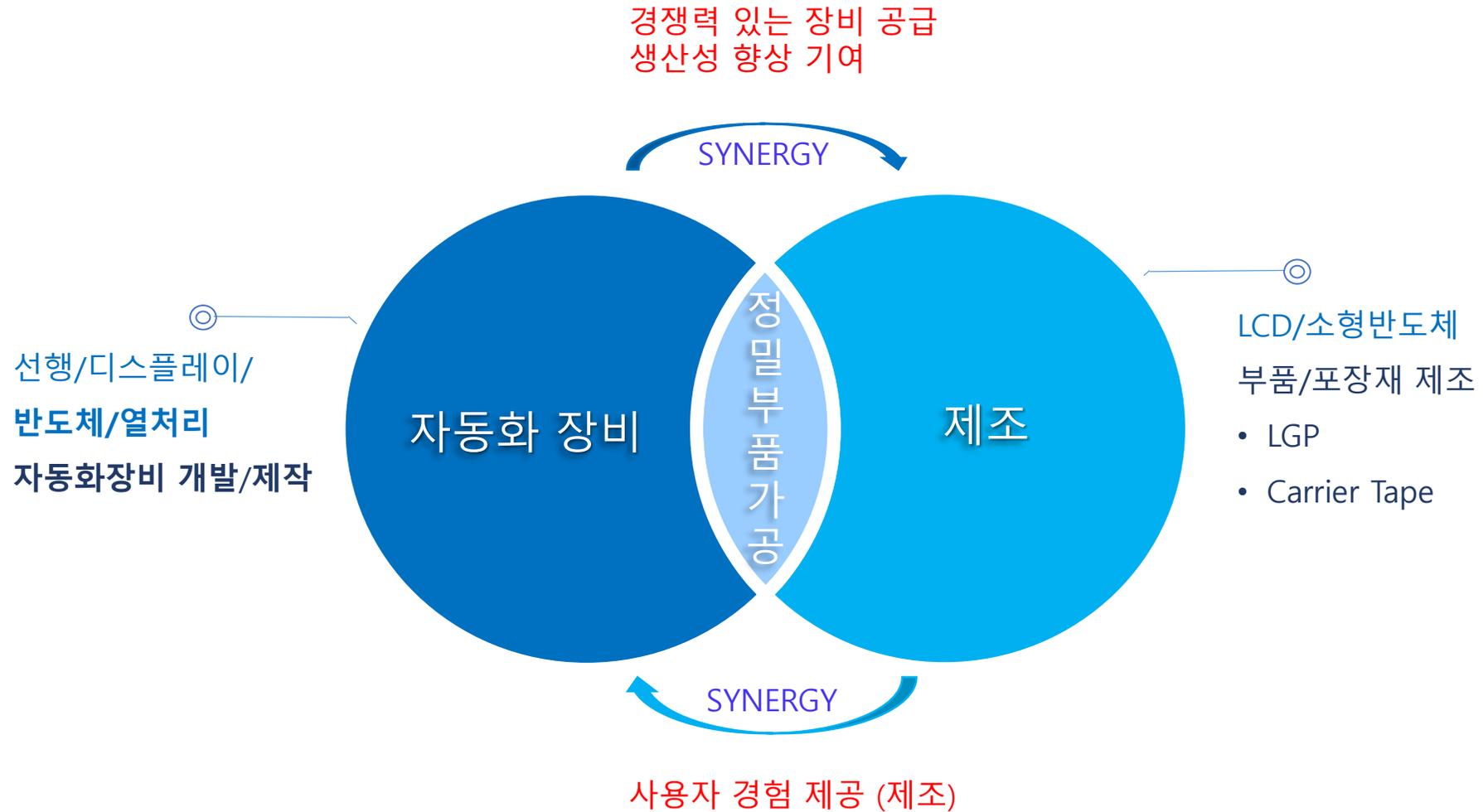
I. 사업소개

1. 사업 경쟁력
2. 사업 영역
3. 사업별 분류_자동화 설비
4. 사업별 분류_부품 & 제조



1. 사업 경쟁력

자동화장비사업(선행/디스플레이/반도체/열처리), 부품사업(정밀부품 가공/ 제조)



2. 사업 영역

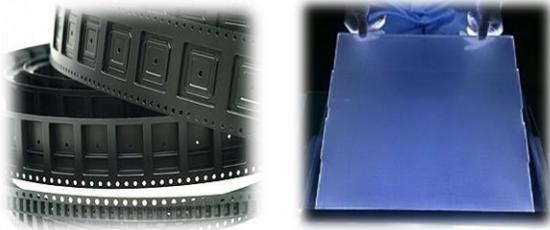
자동화장비사업(선행/디스플레이/반도체/열처리), 부품사업(정밀부품 가공/ 제조)

자동화 장비



- 1) 선행 장비
 - Cell Lami, Module Lami, Lami & Molding for Mini LED BLU
- 2) 디스플레이 관련 장비
 - Roll Stamping, RSM 부대설비 : Laser Pattern / Serration / 보호필름 Lamination, 반전적재
- 3) 반도체 관련 장비
 - Lamination / Trim Form Singulation System / Bending / Laser Deflash & Marking / Tester
- 4) 열처리 장비
 - HVCD (Hot Vacuum Chamber Dryer), HPCP (Hot Plate Cool Plate), IRO (Infrared Ray Oven)
TCO (Thermal Convection Oven)

Carrier Tape & LGP 제조



- 1) 캐리어 Tape
 - PRESS 와 AIR BLOWER 방식의 설비를 모두 보유하고 있어 고객이 요구하는 어떤 모양의 CARRIER TAPE 도 제조 가능
- 2) LGP
 - RSM(Roll Stamping Machin)을 통해 43"~86" LGP를 제조

정밀 부품 가공



- 1) Striper, Die, Bending, Punch, Serration Wheel
 - 고객이 요구하는 다양한 정밀부품가공 수요에 "최적의 솔루션" 으로 최고의 만족을 제공

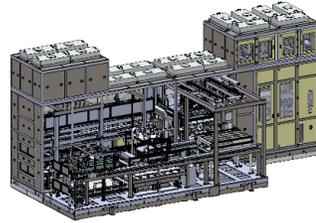
3. 사업 분류_자동화 장비

선행 분야, 디스플레이 분야, 반도체 분야, 열처리 장비 분야

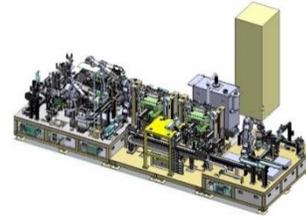
선행 장비

Flexible OLED Panel 제조 공정 내
Top / Bottom Laminator

Mini LED BLU Lami & Molding



Cell Lami



Module Lami



Lami & Molding

Display 장비

BLU에 사용되는 LGP를 Roll Stamping
방식으로 제조/가공하는 자동화장비

Glass Cutting 장비: Laser & Blade Type



ROLL STAMPING
MACHINE



Glass Scribing M/C



LASER PATTERN
MACHINE

반도체 장비

반도체 제조 공정 적용되는 자동화 장비



VACUUM
LAMINATION



SINGULATION SYSTEM



FILM LAMINATION

열처리(Oven) 장비

Display 및 반도체 제조 공정 적용되는
열처리 장비



HVCD



IR Oven



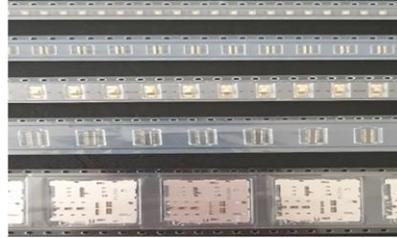
TC OVEN

4. 사업 분류_부품 & 제조

자동화 설비 및 금형의 정밀부품 가공, 반도체 부품 포장재와 디스플레이용 LGP 제조

포장재

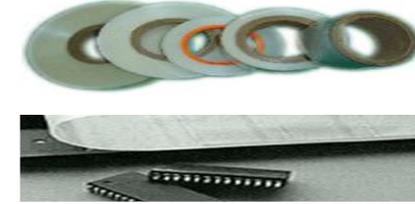
반도체 관련 부품 포장재 제조



Carrier Tape



BOBBIN



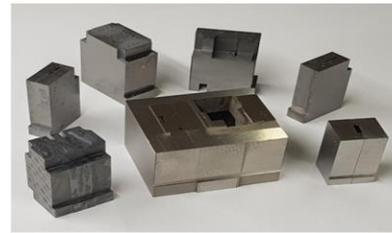
COVER TAPE

부품가공

설비 및 금형에 사용되는 부품 제조/가공



PUNCH



STRIPPER



DIE

LGP 제조

Display용 BLU(Back Light Unit)에 사용되는 LGP(Light Guide Plate) 생산



LGP